

邮电高等学校专科教材

电子电路

邱天富 编 谢沅清 审



人民邮电出版社

邮电高等学校专科教材

电子 电 路

人民邮电出版社

登记证号(京)143号

内 容 提 要

本书共分十二章，包括半导体器件的结构、工作原理与外部特性；晶体管与场效应管基本放大电路的组成及其工作原理；放大器的频率特性；负反馈放大电路；集成运算放大器的原理及其应用；低频功率放大器；高频功率放大器；正弦波振荡器；调制与解调；变频与倍频；直流稳压电源等内容。书中力求简明清晰地阐述半导体器件及其电路的基本原理、基本分析方法，并结合应用实例。

本书可供邮电高等院校或其它工科院校通信电工类专科作为教材，也可供从事相关专业的工程技术人员参考。

邮电高等学校专科教材

电子电路

邱天富 编

谢沅清 审

*

人民邮电出版社出版

北京东长安街77号

人民邮电出版社河北印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

开本：850×1168 1/32 1992年9月 第一版

印张：15 页数：240 1992年9月 河北第1次印刷

字数：398 千字 印数：1—3000 册

ISBN7-115-04735-9/G·183

定价：4.80元

前　　言

电子电路课是通信电子类专业的一门技术基础课。主要学习半导体器件的结构、工作原理和外部特性，电子电路的基本工作原理和基本分析方法。

通过对半导体器件及其电路的分析，应能掌握电子技术中的基本概念，电子电路的工作原理、分析方法和基本工程计算方法。在学习中，应注意理论联系实际，通过实验掌握电子电路的安装、调试方面的基本技能，培养分析问题与解决问题的能力。

限于编者水平，书中难免存在很多缺点或错误，欢迎广大读者批评指正。

编者

1991年12月

2018.2

目 录

第一章 半导体二极管和三极管

第一节 PN结及其单向导电性	(1)
第二节 半导体二极管	(14)
第三节 半导体三极管的工作原理和特性	(24)
本章小结	(39)
习 题	(40)
附录 半导体管型号命名方法	(42)

第二章 基本放大电路

第一节 放大电路的基本分析方法	(44)
第二节 工作点的稳定问题	(75)
第三节 几种基本单元放大电路	(86)
第四节 多级放大电路	(100)
本章小结	(108)
习 题	(109)

第三章 场效应管及其放大电路

第一节 结型场效应管	(115)
第二节 绝缘栅场效应管	(123)
第三节 场效应管放大电路	(132)
本章小结	(140)
习 题	(142)

第四章 放大电路的频率特性

第一节 频率特性的基本概念	(145)
第二节 频率特性的近似图示法	(149)
第三节 单级RC耦合放大器的频率特性	(154)
第四节 多级RC耦合放大器的频率特性	(162)
本章小结	(164)
习题	(164)

第五章 负反馈放大电路

第一节 反馈的基本概念	(167)
第二节 负反馈放大器的基本关系式	(172)
第三节 负反馈对放大器性能的影响	(175)
第四节 闭环放大倍数的近似计算	(185)
*第五节 负反馈放大器的分析方法	(190)
第六节 负反馈放大器的自激与防止	(199)
本章小结	(206)
习题	(207)

第六章 集成运算放大器

第一节 集成电路的特点与分类	(213)
第二节 直接耦合放大器的主要问题	(215)
第三节 差动放大器	(218)
第四节 集成运算放大电路	(233)
第五节 运算放大器的工作原理	(244)
第六节 集成运算放大器的应用	(250)
本章小结	(267)
习题	(268)

第七章 低频功率放大器

第一节 低频功率放大器概述	(274)
第二节 无变压器推挽功率放大器	(278)
第三节 集成功率放大器	(288)
第四节 功率放大电路的安全问题	(290)
本章小结	(293)
习题	(293)

第八章 小信号谐振放大器

第一节 概述	(296)
第二节 谐振回路	(299)
第三节 晶体管的Y参数等效电路	(320)
第四节 单调谐回路谐振放大器	(323)
第五节 双调谐回路谐振放大器	(336)
第六节 集成运放组成的中频放大器	(341)
本章小结	(341)
习题	(342)

第九章 高频功率放大器

第一节 高频谐振功率放大器	(344)
第二节 宽频带功率放大器	(356)
本章小结	(366)
习题	(367)

第十章 正弦波振荡器

第一节 振荡器的基本原理	(369)
第二节 LC振荡器	(374)
第三节 RC振荡器	(383)

第四节 振荡器的频率稳定.....	(388)
第五节 石英晶体振荡器.....	(389)
本章小结.....	(395)
习 题.....	(396)

第十一章 频率变换电路

第一节 概述.....	(400)
第二节 调幅与检波.....	(405)
第三节 调频与鉴频.....	(419)
第四节 锁相环路.....	(428)
第五节 变频.....	(434)
第六节 倍频.....	(441)
本章小结.....	(442)
习 题.....	(443)

第十二章 直流稳压电源

第一节 小功率整流电路.....	(444)
第二节 滤波电路.....	(450)
第三节 硅稳压管稳压电路.....	(453)
第四节 串联式晶体管稳压电路.....	(458)
第五节 单片集成稳压电源.....	(462)
第六节 开关式稳压电源.....	(465)
本章小结.....	(468)
习 题.....	(469)

参考文献..... (471)

第一章 半导体二极管和三极管

本章内容：主要介绍半导体材料的基本知识，PN结的物理特性和单向导电原理，半导体二极管的特性与参数。讨论三极管的工作原理，特性与参数。

第一节 PN结及其单向导电性

一、本征半导体的导电特性

物质结构中可以自由移动的带电粒子统称为载流子。单位体积中载流子的数目称为载流子浓度。物质的导电能力与载流子的浓度有关，例如金属中自由电子的浓度很高，所以它们的导电能力强，称为导体；而橡皮、塑料等物质中自由电子浓度低，所以它们的导电能力差，称为绝缘体。要了解半导体的导电特性，首先应当了解半导体中载流子的情况。

1. 本征半导体及其导电机机构

本征半导体就是纯净的结构完整的半导体晶体，常用的有硅(Si)和锗(Ge)单晶体。它们的导电性能介于导体和绝缘体之间，所以称为半导体。硅和锗都是四价元素，每个原子的外层有四个价电子，它们与相邻原子中的价电子组成共价键。在绝对零度和无外界因素影响时，价电子都被束缚在共价键之中，不能自由移动，不参与导电。这时的半导体不能导电，相当于绝缘体。

当半导体的温度升高时，共价键中的价电子因原子的热振动而获得额外的能量，一些价电子挣脱共价键的束缚成为自由电子。同时在共价键上留下一个空位，这个空位叫做空穴。自由电子带负电，带空穴的原子因失去一个价电子而带正电，把这个正电看成空穴带的正电量。所以空穴所带的正电荷量与电子所带的负电荷量相等。本征半导体中出现一个自由电子，同时产生一个空穴。自由电子和空穴成对出现，称为电子—空穴对。半导体中共价键被破坏，产生电子—空穴对的过程称为本征激发。除加热外，用光照或电场作用也能产生本征激发。

自由电子（简称电子）可以自由移动参与导电，空穴也可以自由移动参与导电。不过空穴移动的方式与自由电子不同，因为相邻原子中的价电子很容易来填充空穴，这时空穴就移到另一个位置上，价电子的移动形成了空穴的移动。可见，半导体中有两种载流子，即自由电子和空穴。

2. 载流子的热平衡浓度

本征激发产生的自由电子和空穴是成对出现。自由电子在热运动中也可能放出能量，填充空穴，修复一个共价键。这时自由电子和空穴又成对消失，这个过程称为复合。在一定的温度下，载流子的激发与复合会达到一个动平衡状态。这时的载流子浓度称为载流子的热平衡浓度。用 n_0 和 p_0 分别表示自由电子和空穴的热平衡浓度，在本征半导体中

$$n_0 = p_0 = n_i$$

n_i 称为本征浓度，可以证明：

$$n_i = AT^{3/2} \cdot e^{-E_a/2kT} \quad (1-1)$$

式中 A 为与材料有关的系数； k 为波尔兹曼常数，等于 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 或 $8.616 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ ； T 为绝对温度，单位用K表示； e 为自然对数的底； E_a 为价电子激发所需要的能量，在常温下($T=300\text{K}$)，硅的 E_a 约为 1.1eV (电子伏特)，锗的约为 0.67eV 。

综上所述：

(1) 半导体中有两种载流子：电子和空穴。电子带负电，空穴带正电。

(2) 本征激发，电子和空穴总是成对出现的。

(3) 半导体中同时存在着载流子的激发与复合。温度一定时，载流子的激发与复合会达到平衡状态。载流子的热平衡浓度与温度和材料有关。常温下，本征半导体的载流子热平衡浓度很低，所以导电性能差。温度升高时载流子的浓度迅速增加，半导体的导电性能增强。这就是半导体的热敏特性，利用它可以制造具有负温度系数的热敏电阻。用光照也可以使半导体中载流子的本征浓度增加，半导体的导电性能增强。这就是半导体的光敏特性。利用这个特性可以制造光敏电阻。此外，半导体还具有掺杂特性。

二、杂质半导体

杂质半导体就是在本征半导体中掺入微量杂质。本征半导体在掺入杂质后导电性能发生显著变化，这就是半导体的掺杂特性。利用半导体的这种特性，人们制成了具有各种性能的半导体器件。根据在本征半导体中掺入杂质的不同，可以分为电子型(N型)半导体和空穴型(P型)半导体两大类。

1. N型半导体

在本征半导体中掺入微量的五价元素(如磷、砷、锑等)，可使半导体内自由电子浓度增加，形成N型半导体，如图1-1所示。

在本征半导体中掺入微量的五价元素后，杂质原子取代晶格中某些硅(或锗)原子。它的五个价电子在与周围的四个硅(或锗)原子的价电子构成共价键时，多余出一个价电子。这个价电子不受共价键的束缚，但仍受本原子核的吸引。与共价键中的价电子相比，这种吸引力很小，只要得到很小的能量就可以挣脱原子核的束缚，成为自由电子。杂质原子失去一个电子成为不能移动的正离子，这

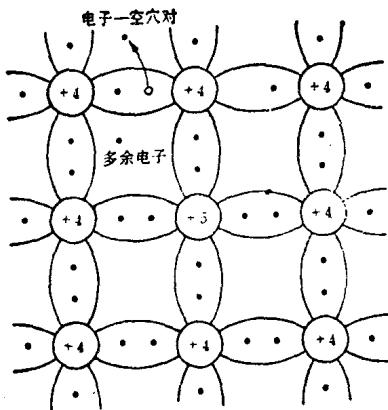


图 1-1 N型半导体晶体结构示意图

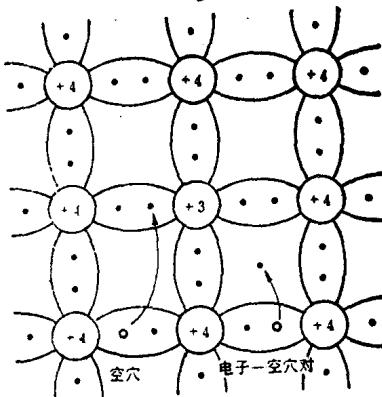


图 1-2 P型半导体晶体结构示意图

个过程称为杂质电离。实际上，在常温条件下杂质原子可以全部电离。五价元素的原子由于电离后给出一个电子，故被称为施主杂质。

在这种半导体中，除本征激发产生的少量电子一空穴对之外，增加了许多由杂质电离而产生的电子。电子的数目远大于空穴的数目，我们把这种主要靠电子导电的半导体称为N型半导体。电子称为多数载流子（简称多子），空穴称为少数载流子（简称少子）。

另外，杂质电离产生一个自由电子，同时出现一个正离子；本征激发电子和空穴成对产生，所以在N型半导体中的电子数目等于正离子和空穴数目之和。电子带负电，正离子和空穴带正电，整块半导体中正负电荷量相等，保持电中性。

2. P型半导体

在本征半导体中掺入微量的三价元素（如硼、铝、镓、铟等），可使半导体内空穴的浓度增加，形成P型半导体，如图 1-2 所示。

本征半导体中掺入三价元素后，杂质原子取代晶格中某些硅（

或锗)原子。由于三价元素的原子只有三个价电子,与周围四个硅(或锗)原子组成共价键时缺少一个价电子,出现一个空位。常温下,相邻原子的价电子很容易填充这个空位。杂质原子因得到一个价电子而成为负离子,同时出现一个空穴,这个过程称为杂质电离。三价元素由于电离后得到一个价电子,故被称为受主杂质。

在这种半导体中,除本征激发产生的少量电子—空穴对之外,还有杂质电离形成的空穴。所以空穴的数目远大于电子的数目,我们把这种主要靠空穴导电的半导体称为P型半导体。空穴称为多数载流子,电子为少数载流子。

另外,杂质电离后成为负离子,产生一个空穴;本征激发电子和空穴成对出现,所以在P型半导体中空穴数目等于负离子和电子数目之和。空穴带正电,电子和负离子带负电,整块半导体中正负电荷量相等,保持电中性。

综上所述:

(1)本征半导体中掺入五价元素,形成N型半导体。N型半导体中,电子是多数载流子,空穴是少数载流子,此外还有不能参与导电的正离子。

(2)本征半导体中掺入三价元素,形成P型半导体。P型半导体中,空穴是多数载流子,电子是少数载流子,此外还有不能参与导电的负离子。

(3)杂质半导体中,存在有主要由杂质电离产生的载流子,还有由本征激发产生的电子—空穴对。多子的浓度取决于杂质的浓度,少子的浓度取决于本征激发,与温度有关。

三、PN结

把P型和N型半导体紧密地结合起来,在两者的交界面处将形成一个特殊的带电薄层,这个带电薄层就是PN结。PN结是半导体

器件的基础，所以要了解半导体器件的工作原理和特性，首先要熟悉PN结的原理和特性。

1. PN结的形成

P型和N型半导体紧密地结合在一起时，在交界面两侧有明显的载流子浓度差。把N型半导体一侧称为N区，P型半导体一侧称为P区。N区的电子浓度比P区的电子浓度高；P区的空穴浓度比N区的空穴浓度高。载流子在浓度差的作用下，向浓度低的方向运动，称为扩散运动。载流子扩散运动形成的电流称为扩散电流，它的大小与载流子的浓度差成正比，与载流子的浓度无关。由于浓度差的存在，N区的多子—电子要向P区扩散；P区的多子—空穴要向N区扩散。那么，这种扩散是否能持续到两边的电子和空穴浓度分布均匀为止呢？不是的，因为电子和空穴都是带电粒子，当N区靠近交界面处的电子进入P区后就会在N区留下一个不能移动的正离子；同样，P区的空穴进入N区后就会在P区留下一个不能移动的负离子。于是，在交界面两侧形成一个很薄的正、负离子层，N区一侧带正电，P区一侧带负电，称为空间电荷区，如图1-3所示。空间电荷区形成后，由于正负电荷互相作用，形成一个电场，称为内建电场，用 $\epsilon_{\text{内}}$ 表示，其方向是由N区指向P区的。这个内建电场对多数载流子的扩散运动有阻碍作用，但在内建电场的作用下，少数载流子（N区的空穴向P区，P区的电子向N区）作定向运动，这种在电场力的作用下载流子的定向运动称为漂移运动。载流子漂移运动形成的电流称为漂移电流，其大小与载流子的浓度和电场强度成正比。

开始时，内建电场较弱，多数载流子的扩散运动占优势。随着扩散的进行，空间电荷数量增加，空间电荷区变厚，内建电场增强。多数载流子的扩散运动减弱，少数载流子的漂移运动增强。当多子的扩散运动与少子的漂移运动平衡时，空间电荷数量不再增加，空间电荷区的厚度相对稳定，内建电场达到稳定值，PN结达到平衡状态。所以，PN结是载流子扩散运动与漂移运动平衡的产物。

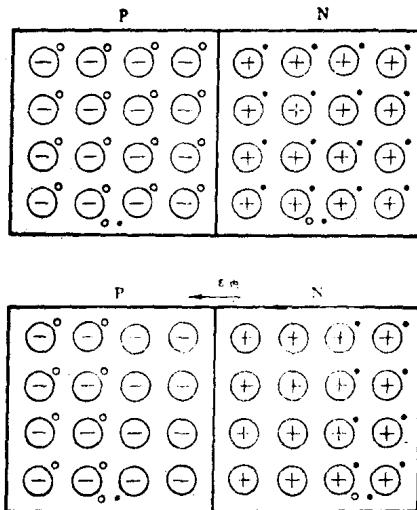


图 1-3 PN结的形成

空间电荷区是缺少载流子的高阻区，近似地认为载流子被“耗尽”，剩下不能移动的正、负离子，因此空间电荷区又称为耗尽区。

内建电场的形成，说明空间电荷区两边电位不等，N区电位比P区高。这个电位差称为接触电位差或电位壁垒（简称位垒）。位垒对多子的扩散有阻碍作用，所以空间电荷区又被称为阻挡层或位垒区。位垒用 U_j 表示，其大小与半导体材料、掺杂浓度和温度有关。通常：

$$\text{硅 } U_j = 0.6 \sim 0.8 \text{ V}$$

$$\text{锗 } U_j = 0.2 \sim 0.3 \text{ V}$$

总之，在P型和N型半导体交界面处，由于载流子的浓度差而产生多子的扩散运动。扩散的结果形成空间电荷区，形成内建电场。内建电场阻碍多子的扩散运动，使少子产生漂移运动。多子的扩散运动与少子的漂移运动平衡时，通过交界面的净载流子数为零，内建电场达到稳定值，PN结达到平衡状态。

2. PN结的单向导电性

PN结单向导电性，就是在P区接电源的正极，N区接电源的负极时，有一定的电流流过。外加电压升高，流过PN结的电流迅速增大；当P区接电源负极，N区接电源正极时，流过PN结的电流却很微小，且电流的数值基本上不随外加电压变化。

P区接电源正极，N区接电源负极的运用方式，称为PN结正向运用或正偏。P区接电源负极，N区接电源正极的运用方式，称为PN结反向运用或反偏。

(1) PN结外加正向电压

PN结未加电压时，处于平衡状态：多数载流子的扩散运动与少数载流子的漂移运动相对平衡，流过PN结的电流为零。

当PN结外加正向电压 U_F 时，由于空间电荷区是高阻区，所以外加电压大部份降在空间电荷区上，建立一个外加电场 $E_{外}$ ，如图1-4(a)所示。

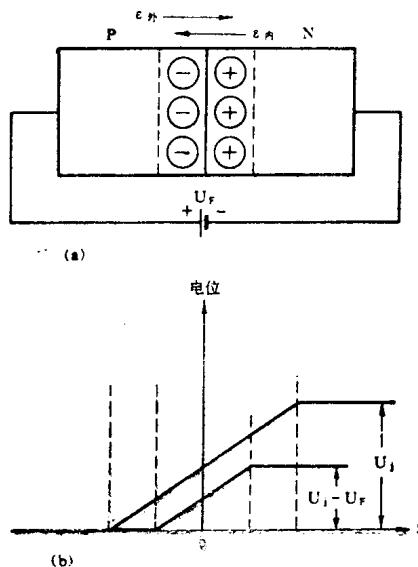


图 1-4 PN结外加正向电压

外加电场 $\epsilon_{\text{外}}$ 的方向与内建电场 $\epsilon_{\text{内}}$ 方向相反，抵消部分内建电场，使位垒降低为 $U_j - U_F$ ，如图1-4(b)所示。破坏了PN结原来的平衡状态，多子的扩散运动强于少子的漂移运动，形成较大的正向电流。PN结呈(低阻)导通状态。

外加正向电压时，PN结电流的形成如图1-5所示。图(a)表示PN结外加正向电压 U_F 时，空间电荷区变薄，位垒降低。图(b)为PN结中性区内载流子浓度分布曲线。图(c)为流载子运动与PN结正向电流形成示意图。

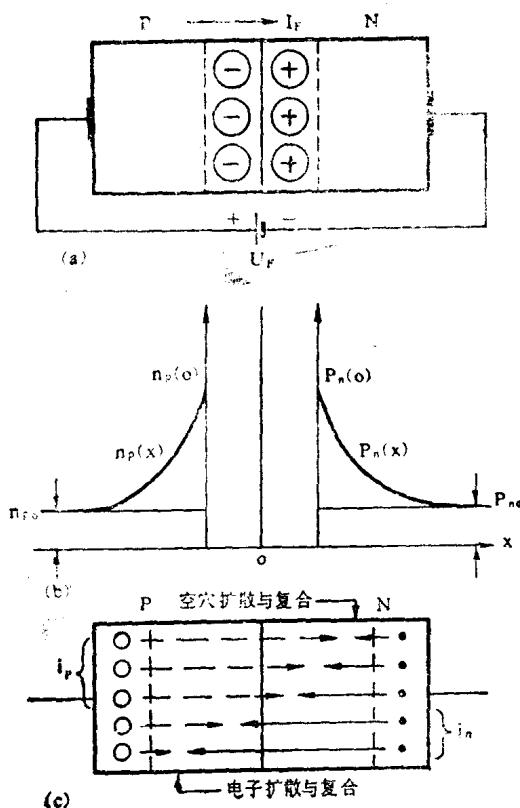


图 1-5 外加正向电压时PN结电流的形成